



写真提供：多摩産業交流センター指定管理共同企業体

第40回エレクトロニクス実装学会 **春季講演大会**

日時：2026年3月10日(火)～12日(木)

場所：東京たま未来メッセ 東京都立多摩産業交流センター（八王子市）

【ハイブリッド開催：オンライン視聴可能】

交流会：2026年3月11日(水) モータウンバグダッドカフェ八王子 (the b) 先着150名

春季講演大会 ホームページ: <https://jiep.or.jp/event/convention/jiep2026s/>

≪講演(発表)・ポスター・企業展示 募集≫ 12月19日(金)締切！

≪参加登録≫ 1月31日まで早期割引

本大会は、エレクトロニクス実装技術に関する最新の研究開発成果を互いに発表し情報交換をする場として、現地参加とオンライン聴講を可能にしたハイブリッドにて開催をしております。
特別講演2件、依頼講演・一般発表150件、ポスター発表10件、企業展示30社ほど予定しており、産学のエレクトロニクス実装技術関係者等がオンライン聴講含め700人以上集う大会となります。



【参加費 (消費税込み)】 講演大会の講演(発表)、聴講(参加)、オンライン視聴、予稿データダウンロード含む

講演(発表)者 聴講(参加)者	参加登録期間	早期 参加費	通常 参加費
		2026年1月31日迄	2026年2月1日～3月12日
会員	正会員	15,000円	17,000円
	海外会員	15,000円	17,000円
	若手会員	15,000円	17,000円
	シニア会員	7,000円	9,000円
	名誉会員	無料	
	学生会員(予稿DL無し)	無料	
	学生会員(予稿DL有り)	1,000円	
賛助会員	賛助会員	15,000円	17,000円
	クーポン	使用可 (1枚)	
共催会員	一般	15,000円	17,000円
	学生★	3,000円	3,500円
協賛会員	一般	20,000円	22,000円
	学生★	4,000円	4,500円
非会員	一般	28,000円	30,000円
	学生★	5,000円	5,500円

★学生：当学会入会後の参加登録がお勧めです。

オプション	交流会(先着150名)	6,000円
	予稿集冊子版	4,000円 送料込み (日本のみ発送)

※予稿集冊子版：開催終了後の3月末までに登録住所へレターパックにて郵送予定



写真提供：多摩産業交流センター指定管理共同企業体



特別講演会場

特別講演

3月11日(水) 展示室A

【1】 15:10～16:10 予定

「小型月着陸実証機SLIMの成果とエレクトロニクス技術」

宇宙航空研究開発機構 宇宙科学研究所 教授

福田 盛介 氏

月表面への高精度着陸技術の獲得と探査機システムの軽量化をミッション目的とした小型月着陸実証機SLIMは、2024年1月に月面の「神酒の海」の西方に到達した。SLIMの開発においては、世界でも例のない100m級の着陸精度を目指すピンポイント着陸を、200kg未満（推進薬除く）の機体で実現するため、宇宙機システムや誘導航法制御に関する多様な研究開発を実施した。本講演では、着陸降下中に機上で自律的に位置を推定する画像航法技術や運用の成果を紹介しつつ、SLIMの開発を支えた電子部品実装などのエレクトロニクスに関する話題について述べる。



【2】 16:20～17:20 予定

「ICチップのセキュリティに向けたパッケージと回路技術の進化（仮）」

神戸大学 教授

永田 真 氏

半導体ICチップのハードウェアセキュリティにおいて、パッケージと回路の協創による技術の進展が求められている。ICチップに搭載された暗号モジュールにおけるサイドチャネル攻撃や故障注入攻撃などの脅威が知られており、その対策は急務である。本講演では、高いセキュリティ信頼性の獲得に向けて、ICチップの電源供給性能の改善、電磁環境応答特性の制御、そして赤外光の照射への対策など、パッケージと回路の協創による様々な技術の可能性があることについて、シリコンチップによるデモンストレータの設計・評価の事例を含めて紹介する。

